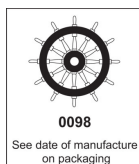
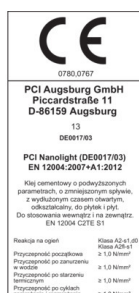
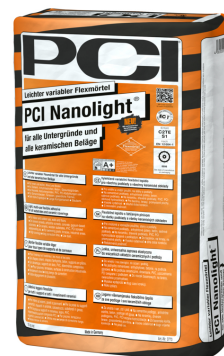


Uniwersalna, wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca

PCI Nanolight[®]

do wszystkich rodzajów podłoża i wszystkich okładzin ceramicznych



Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do ścian, posadzek i sufitów.
- Do wyklejania **metodą cienko- i średniowarstwową**, we wnętrzach i na zewnątrz budynków, chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych: glazury, terakoty, kamionki, mozaiki ceramicznej, klinkieru, płytek ceglanych, cotto, gresu itp.
- Do stosowania na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych, jak np.: beton monolityczny, tynki cementowe, wapienno-cementowe, wapienne i gipsowe, jastrychy i wylewki cementowe i anhydrytowe, lastriko, płyty kartonowo-gipsowe, cementowo-włóknowe, drewniane płyty wiórowe i płyty OSB, zespolone uszczelnienia podpłytkowe (np. PCI Lastogum[®], PCI Seccora[®], PCI Barraseal[®], PCI Apoflex[®], PCI Pecilastic[®] W i U), stare powłoki malarskie, stare okładziny płytkowe, stare wykładziny PVC, ogrzewania podłogowe i ścienne, podłoża metalowe we wnętrzach obiektów, płyty budowlane PCI PowerBoard[®].
- Do klejenia płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia oraz płytek i mozaiki szklanej.
- Do okładzin płytkowych w pomieszczeniach suchych i mokrych (łazienkach, umywalniach), na balkonach, tarasach, fasadach nieocieplonych i ocieplonych, w zbiornikach wodnych, w nieckach i na plażach basenów pływakich.
- Do okładzin posadzkowych narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne i naprężenia wywołane zmianami temperatury.

- Do wyrównującego szpachlowania podłoży mineralnych w zakresie grubości 1 do 10 mm.
- Do przyklejania na podłożach betonowych, murowanych i tynkowanych płyt styropianowych w celu obwodowego ocieplenia podziemnych części budynków.
- Do przyklejania płyt styrodurewych i z wełny mineralnej.
- W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.
- Idealna zaprawa klejąca do robót remontowych – uniwersalna, bardzo wydajna, o optymalnych parametrach czasowych.



Wszechstronne stosowanie - do wszystkich podłoży i wszystkich okładzin ceramicznych

Właściwości produktu

- Odpowiada klasie **C2TE S1 wg normy PN-EN 12004**.
- Doskonała urabialność i konsystencja.
- **Bardzo wysoka wydajność** dzięki zastosowaniu unikalnej kombinacji lekkich napełniaczy, np. tylko ok. **1,8 kg/m² przy użyciu packi zębatej 8 mm**.
- **Brak spływu** na powierzchniach pionowych, nie wymaga podparcia nawet płytek o znacznym ciężarze powierzchniowym.
- **Mrozo- i wodoodporna**.
- **Bezscurczowe** wiązanie w zakresie grubości warstw od **1 do 10 mm**.
- Wykazuje **wysoką (nawet do 2 N/mm²) przyczepność** po różnych rodzajach starzenia, nadaje się na najtrudniejsze podłoża (np. metalowe) oraz do najtrudniejszych okładzin (np. szklanych).
- **Wysoko-elastyczna (S1) – kompensuje znaczne odkształcenia podłoża** wynikające np. z dużych zmian temperatury.
- **Plastyczna** - łatwa w obróbce.
- Idealna w robotach remontowych: długi czas użycia i korekty, szybkie wiązanie.
- Ekologiczna – **niskopyląca i niskoemisyjna** w odniesieniu do substancji szkodliwych – oznaczona znakiem **EMICODE EC 1 PLUS**.

Dane techniczne

Baza materiałowa	sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie dobranych dodatków	
Składniki	produkt 1-składnikowy	
Opakowanie	wzmocniony worek z uchwytem, 15 kg z wkładem polietylenowym	
Składowanie	w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 C	
Trwałość składowania	12 miesięcy	
Konsystencja	plastyczna	
Kolor	szary	
Paca zębata:	Zużycie/m ² ok.:*	Wydajność worka 15 kg, ok.:*
- 4 mm	0,9 kg	16,7 m ²
- 6 mm	1,3 kg	11,5 m ²
- 8 mm	1,8 kg	8,3 m ²
- 10 mm	2,1 kg	7,1 m ²

Na m ² i mm grubości warstwy	0,8 kg
Grubość warstwy kleju	od 1 do 10 mm
Temperatura aplikacji i podłoża	+5 °C do +25 °C
Ilość wody zarobowej	
- na 1 kg suchej mieszanki	ok. 0,44 do 0,47 l
- na worek 15 kg	ok. 6,6 do 7,0 l
Czas dojrzewania	ok. 3 minuty
Czas użycia**	ok. 90 minut
Czas otwarty klejenia**	ok. 30 minut
Czasy utwardzania**	
- wchodzenie możliwe po	ok. 8 godzinach
- spoinowanie możliwe po	ok. 8 godzinach
- pełne obciążenie możliwe po	ok. 24 godzinach
Spływ	≤ 0,5 mm
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Odporność termiczna	-30 °C do +80 °C
Reakcja na ogień	A2-s1,d0/A2fl-s1

* Na zużycie PCI Nanolight® wpływa wielkość i struktura tylnej strony zastosowanej okładziny oraz stopień wyrównania podłoża. W praktyce zużycie może wykazywać odchylenie od podanych wartości.

** Przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

Przygotowanie podłoża

- Minimalny wiek podłoża:
 - jastrych PCI Novoment® M1 plus: ok. 24 godziny;
 - jastrych PCI Novoment® Z3: ok. 3 dni;
 - tradycyjna posadzka cementowa: ok. 28 dni;
 - tradycyjne tynki cementowe: ok. 28 dni;
 - beton: ok. 3 miesiące.
- Podłoże powinno być równe, zwarte, nośne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- Do wyrównywania posadzek zaleca się użycie masy poziomującej PCI Pericem®. Do równania ścian i sufitów oraz do punktowego równania posadzek można użyć mas szpachlowych PCI Pericret®, PCI Nanocret® R2, PCI Nanocret® FC.
- Silnie chłonne podłoża cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® w rozcieńczeniu 1:1 lub 1:2 z wodą albo PCI Gisogrund® OP w rozcieńczeniu 1:1 z wodą.
- Podłoża gipsowe zagruntować nie rozcieńczonym środkiem PCI Gisogrund® lub PCI Gisogrund® OP.

PCI Nanolight®

- Podłoża niechłonne (np. stare farby olejne, stare okładziny płytkowe, lastryko, płyty OSB, metal, PVC) należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® 404 lub PCI Gisogrund® 303.
- Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych gruntować środkiem PCI Wadian®.
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność szczątkowa, mierzona metodą CM, powinna wynosić dla:
 - podłoży cementowych: 4%;
 - dla podłoży gipsowych: 0,5%.

Sposób użycia

Przygotowanie zaprawy klejowej

- 1 Wlać do czystego naczynia odpowiednią ilość wody zarobowej. Wsypać zawartość opakowania i wymieszać odpowiednim mieszadłem (maks. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, plastycznej zaprawy.
- 2 Odczekać ok. 3 minuty i powtórnie krótko wymieszać.

Wyrównawcze szpachlowanie podłoża

- 1 Aplikacja analogiczna jak w przypadku szpachlówek cementowych.
- 2 W typowych warunkach po ok. 5 godzinach na ścianach i po ok. 24 godzinach na posadzkach na wyszpachlowanym podłożu można przyklejać płytki.

Wyklejanie okładzin

- 1 Najpierw gładką stroną pacy rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową.
- 2 Następnie odpowiednią pacą zębatą nanieść (możliwie w jednym kierunku) na świeżą warstwę kontaktową zaprawę klejową. Nanosić tylko tyle zaprawy, ile można obłożyć płytkami w czasie otwartym klejenia. Opuszkami palca kontrolować czas naskórkowania zaprawy.
- 3 Lekko posuwistym ruchem ułożyć płytki na zaprawie klejowej, docisnąć i ustawić we właściwym położeniu.

Spoinowanie

- Do wypełnienia spoin użyć odpowiednich zapraw spoinowych, np. PCI Nanofug®, PCI Nonofug® Premium czy PCI Durapox®.
- Spoiny dylatacyjne wypełnić właściwymi uszczelniaczami, np. PCI Silcofug® E lub PCI Elritan®.

Zalecenia i uwagi

- W przypadku wyklejania kamieni naturalnych wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia należy używać dedykowanych do tego zapraw klejowych PCI Carrament®. W razie wątpliwości co do właściwości danego kamienia, zaleca się wykonanie próbnego przyklejenia i na tej podstawie dobranie odpowiedniej zaprawy klejowej.
- Do płytek i mozaiki wykonanych z przezroczystego szkła użyć białego kleju PCI Nanolight® White.
- Jeżeli spód okładziny szklanej pokryty jest materiałem wrażliwym na działanie alkaliów, użyć do jej przyklejenia epoksydowej zaprawy klejącej PCI Durapox®.
- Na balkonach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniach podłogowych i ściennych, w basenach pływackich i kąpielowych oraz w przypadku okładzin płytkowych poddanych wysokim obciążeniom mechanicznym (np. naciskom kół pojazdów czy podpór ciężkich elementów wyposażenia), należy zastosować klejenie metodą kombinowaną lub użyć zaprawy płynnowarstwowej PCI Flexmörtel® S1 Flott, celem zapewnienia podklejenia min. 95% powierzchni płytki.
- Po 7 dniach od przyklejenia płytek na zaprawie PCI Nanolight® możliwe jest (w typowych warunkach klimatycznych) uruchomienie ogrzewania podłogowego.
- Płyty wiórowe i płyty OSB winny mieć na ścianie grubość min. 19 mm, a na posadzce min. 25 mm. Należy je przykręcić do legarów nie rzadziej niż co 40 cm. Ten maksymalny rozstaw wkrętów obowiązuje w obu prostopadłych kierunkach. Obwodowa spoina dylatacyjna przy ścianach winna wynosić min. 8 mm. Styki płyt powinny być skleione.
- Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą, ani nie mieszać ze świeżą zaprawą.
- Nie dodawać do zaprawy klejowej żadnych substancji poza czystą wodą zarobową.
- Jeśli nie ma innych wymagań, należy zapewnić podklejenie zaprawą klejową min. 65% powierzchni płytki.

- Przed spoinowaniem usunąć spomiędzy płytek jeszcze w stanie świeżym resztki zaprawy klejowej.
- Płyty termoizolacyjne mogą być generalnie przyklejane metodą „na placki”, chyba, że przewiduje się na nich dodatkowe warstwy materiałów. Wówczas konieczne jest przyklejanie pełnopowierzchniowe.
- Przed przyklejaniem płyt styrodurowych należy przetrzeć ich spodnią powierzchnię szczotką drucianą w celu poprawy przyczepności zaprawy klejącej.
- Nie stosować do przyklejania płyt styropianowych na podłożach bitumicznych.
- W przypadku klejenia płyt termoizolacyjnych na sufitach stosować dodatkowe dyblowanie ich do podłoża.
- Narzędzia zaleca się umyć wodą krótko po użyciu, gdyż później wymaga to więcej wysiłku.

Wskazówki BHP

Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. W razie połamania niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub niniejszą informację o produkcie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.

Wydanie: 6/23

Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność.

Najnowsze wydanie aktualnej karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl

Sika Poland Sp. z o.o.

Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

Tel. +48 606 102 281

pci-polska@pci-group.eu

www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej. Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.